

新闻稿

ASM Pacific Technology 通过新收购扩大先进封装的产品组合

新加坡与香港，2018年4月3日- ASM Pacific Technology Ltd. (「ASMPT」) 今天宣布，它已经与 Tokyo Electron Limited (「TEL」) 签署了一项最终协议，收购 TEL NEXX 公司 (「NEXX」)。预计这笔交易将在收到有关当局的批准后完成。此次收购是集团继续推行其发展策略的又一重大举措，着重发展新的高增长市场和扩大其于半导体先进封装市场的产品供应。

成立于 2001 年，NEXX 是先进封装市场的业界领导者，在高度专业的电化学沉积 (「ECD」) 和物理气相沉积 (「PVD」) 技术领域拥有强大的技术能力。这项新收购业务将纳入 ASMPT 的后工序设备业务分部。

「这次策略收购补充我们目前提供的先进封装应用产品，并将 ASMPT 打造成首屈一指的互连技术公司，同时履行我们致力于推动创新并为客户提供最高价值和创新解决方案的承诺。通过结合 NEXX 高度专业的 ECD 和 PVD 技术，我们看到先进封装市场庞大的发展机遇，这有助发展我们的业务，并增强这些由数据主导时代所推动的市场。」ASMPT 集团行政总裁李伟光先生表示。

TEL 主席兼行政总裁 Toshiaki Kawai 表示：「ASMPT 为 NEXX 提供了一个令人振奋的机会，提高和扩充其晶圆级封装，ECD 和 PVD 产品。TEL 认为 NEXX 将受益于与 ASMPT 的外判组装和测试客户网络而获得更大的协同效应。

「随着对半导体设备的需求处于历史高位，我们期待通过 ASMPT 增加全球客户的覆盖面，并为我们的客户扩大销售和服务能力。」NEXX 主席 Tom Walsh 解释。

(完)

新闻垂询：

香港

纵横财经公关顾问有限公司

吴燕霞

电话: (852) 2864 4812

电邮: mandy.go@sprg.com.hk

新加坡

黄凤玲

高级企业传播经理

电话: (65) 6750 9567

电邮: joey.ng@asmpt.com

网页: www.asmpacific.com

关于 ASM Pacific Technology Limited

作为全球科技及市场领导者，ASMPT(香港联交所股份代号: 0522)致力为全球半导体装嵌及封装行业研发及提供尖端解决方案及物料。其表面贴装技术解决方案广泛应用于不同的终端用户市场，包括一般电子产品、移动通信器材、汽车工业、工业、LED 以及替代能源。

ASMPT 自一九八九年起于香港联交所上市。目前，ASMPT 已获纳入为恒生综合市值指数下之恒生综合中型股指数、恒生综合行业指数下之恒生综合资讯科技业指数、恒生香港 35 指数及恒生环球综合指数的成份股。欲了解更多关于 ASMPT 的信息，请游览我们的网页 www.asmpacific.com。

关于 NEXX

NEXX 成立于 2001 年，开发了供应半导体先进封装市场的电化学沉积（「ECD」）和物理气相沉积（「PVD」）技术。TEL USA 是 TEL 的全资直属子公司。TEL 于 2012 年收购了 NEXX，NEXX 成为 Tokyo Electron U.S Holdings, Inc 的全资直属子公司。